

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

682

ML8

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

26.01.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	210		2
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3
C-RS-FR4-ML-0.51mm-105+105-TG150-HF	50200884	105	L2	4 A01
		510		
		105	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	230		5
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		6
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		7
C-RS-FR4-ML-0.51mm-105+105-TG150-HF	50200884	105	L4	8 A02
		510		
		105	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	230		9
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		10
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		11
C-RS-FR4-ML-0.51mm-105+105-TG150-HF	50200884	105	L6	12 A03
		510		
		105	L7	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	210		13
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		14
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	15

Dicke nach Verpressen

B00:

3090 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3410 µm

Dmin:

2770 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

3200 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3520 µm

Dmin:

2880 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

3110 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik